

宏微科技：芯片为核心 模块为基础 应用方案为牵引 打造功率半导体产业链——江苏宏微科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放

出席嘉宾

江苏宏微科技股份有限公司董事长、总经理
江苏宏微科技股份有限公司董事、副总经理和董事会秘书
江苏宏微科技股份有限公司财务总监

赵善麒先生
丁子文先生
薛红霞女士

民生证券股份有限公司投资银行事业部董事总经理、保荐代表人
民生证券股份有限公司投资银行事业部执行董事、保荐代表人

范信龙先生
梅明君先生

江苏宏微科技股份有限公司
董事长、总经理赵善麒先生致辞



尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位网友：大家好！

欢迎大家参加江苏宏微科技股份有限公

司首次公开发行A股并在科创板上市网上路演活动。在此，我谨代表公司，向长期以来关心江苏宏微科技股份有限公司发展的各位领导和各界友人表示衷心的感谢！同时也感谢上证路演中心和中国证券网为此次网上路演活动提供的专业服务。希望通过此次网上交流活动，充分客观地解答各位投资者所关心的问题，让大家更加全面地了解江苏宏微科技股份有限公司。

江苏宏微科技股份有限公司成立于2006年，公司主要从事以IGBT、FRED为主的功率半导体器件的设计、研发、生产和销售。经过十余年的发展，公司现已形成了较强的具有自主知识产权的IGBT、FRED芯片设计能力，包括芯片版图设计和工艺设计、封装设计与制造、特性分析与可靠性试验、失效分析与应用研究等，并积累了大量的规模化生产和质量控制管理经验，产品质量和服务水平赢得了客户的广泛认可。

未来，公司将不断追赶国外领先技术，借鉴先进经验，同时借助资本市场力量，整合更多的上下游资源，引进更多的国内外功率半导体人才，以研发生产出更高效、更可靠的功率半导体器件，为国内整机应用客户提供更优质的产品。

今天非常高兴能与投资者和各界朋友进行网上互动，让大家能够更加深入地了解江苏宏微科技股份有限公司的投资价值及未来发展规划。非常欢迎大家对江苏宏微科技股份有限公司提出问题和建议，我们将再接再厉，向着更高的目标迈进，与各位投资者共享发展成果。

接下来，欢迎大家踊跃提问。谢谢大家！

民生证券股份有限公司
投资银行事业部董事总经理、保荐代表人
范信龙先生致辞



尊敬的各位嘉宾、各位投资者：大家好！

首先，请允许我代表本次发行的保荐机构和主承销商民生证券，向参加本次江苏宏微科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市推介会的各位嘉宾和投

资者朋友表示热烈的欢迎和衷心的感谢！

宏微科技自设立以来一直从事IGBT、FRED为主的功率半导体芯片、单管、模块和电源模组的设计、研发、生产和销售，并为客户提供功率半导体器件的解决方案。多年以来，宏微科技不断创新，积累了众多优秀核心技术，为推动我国功率半导体材料、芯片、封测的发展作出了很大贡献。

在与宏微科技合作的过程中，我们见证了公司取得的骄人业绩，深刻感受到了公司的巨大发展潜力。我们相信，在以赵善麒董事长为核心的专业团队带领下，宏微科技将会进一步巩固行业内的优势地位，创造出更加优异的业绩，为广大投资者带来丰厚的回报。

最后，我代表民生证券，预祝宏微科技本次发行取得圆满成功！并祝愿宏微科技未来在生产经营和资本市场上创造出更加辉煌的成绩！谢谢大家！

江苏宏微科技股份有限公司
董事、副总经理和董事会秘书丁子文先生致结束词



尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位网友：大家好！

时间过得很快，江苏宏微科技股份有限公

司首次公开发行A股并在科创板上市网上路演活动已接近尾声。非常感谢各位网友和投资者对宏微科技的关心，在此，感谢上证路演中心和中国证券网为我们提供这么好的沟通平台和优质的服务。同时，还要感谢保荐机构民生证券，以及所有为宏

微科技发行上市辛勤付出的朋友！

今天，能有机会和广大投资者在一起相互探讨，我感到非常荣幸。相信通过此次互动交流，大家对宏微科技有了更多认识，对公司的的发展历程、业务范围、经营业绩、募投项目、发展战略等有了更深入的了解。与此同时，我们也收到了广大投资者对宏微科技提出的宝贵建议，我们将认真反馈和吸收，努力提升自身经营管理水平。再次感谢大家对宏微科技的信任和支持！

未来，在各级主管部门、监管机构、保荐机构以及广大投资者等社会各界的帮助和支持下，宏微科技将充分把握市场机遇，严格按照相关法律法规要求，及时、完整、准确地做好信息披露工作，以更加优良的业绩回报股东，回报投资者，回报社会。

网上路演即将结束，我们真诚地希望大家持续通过各种方式与我们保持密切的沟通和联系。我们一定会更加努力地牢牢抓住资本市场赋予我们的发展机遇，把公司打造成行业内的标杆企业，成为一家值得广大投资者信赖的上市公司！谢谢大家！



经营篇

问：公司的主营业务是什么？

赵善麒：公司主要从事以IGBT（绝缘栅双极型晶体管）、FRED（快恢复外延二极管）为主的功率半导体芯片、单管、模块和电源模组的设计、研发、生产和销售，IGBT、FRED单管和模块的核心是IGBT芯片和FRED芯片，公司拥有自主研发设计市场主流IGBT和FRED芯片的能力。公司主营业务中的芯片、单管产品完全采用自研芯片，模块产品分别采用自研芯片和外购芯片。

公司根据市场和客户需求，系列化研发和生产功率半导体芯片、单管、模块和电源模组产品，目前公司产品已涵盖IGBT、FRED芯片及单管产品100余种，IGBT、FRED、整流二极管及晶闸管等模块产品400余种，公司产品性能与工艺技术处于行业先进水平，产品集中应用于工业控制，如变频器、逆变电焊机、UPS电源等；部分产品应用于新能源发电，如光伏逆变器、SVG（静止无功补偿器）、APF（有源电力滤波器）等；新能源汽车，如新能源大巴汽车空调、新能源汽车电控系统、新能源汽车充电桩；白色家电，如空调、电冰箱、微波炉等领域。

问：公司有多少控股子公司及参股公司？

丁子文：截至招股说明书签署日，公司共有2家子公司：宏电节能和启帆星；无参股公司；2家分公司：宏微科技深圳分公司和宏微科技北京分公司；曾参股一家公司：宏英半导体。

问：公司拥有多少专利？

赵善麒：截至2020年12月31日，公司共拥有95项授权专利，其中发明专利35项。

问：公司承担了多少个科研项目？

赵善麒：公司先后与上海交通大学、天津大学、中国科学院电工研究所、无锡华润安盛科技有限公司和苏州汇川技术有限公司合作，共同承担了5个科研项目。

问：请介绍公司的营业收入和产品收入情况。

薛红霞：报告期内（2018年、2019年、2020年，下同），公司营业收入分别为26249.27万元、25972.09万元、33162.93万元，其中芯片（含受托加工）、单管及模块产品合计销售收入分别为22139.07万元、24699.47万元和31718.36万元。

问：公司2020年主营业务收入增长的原因是什么？

薛红霞：2020年度公司主营业务收入同比增长27.56%，增长速度较快，主要原因有：1）自2019年海外不确定性增加以来，国内半导体厂商的自主意识亦不断加强，公司自研芯片IGBT模块收入得以快速增长；2）2020年初受疫情影响，部分国外厂商产能、产量受到了较大影响，在进口芯片、模块供给较为紧张情况下，部分客户转而寻找国内同类产品供应商。凭借优质的产品和服务，公司增加了对该等客户的销售。

问：公司的毛利率是多少？

薛红霞：报告期内，公司主营业务毛利率总体保持稳定，分别为22.03%、23.44%和23.22%，其中模块产品毛利率分别为21.33%、21.86%和21.71%，电源模组产品毛利率分别为13.56%、7.01%和9.03%，电源模组产品毛利率水平较低，功率半导体模块、单管及芯片毛利率各年间略有波动，主要受具体销售产品结构变动所致。

2020年度，公司依照自2020年1月1日起执行的“新收入准则”规定，将运输费用作为合同履约成本在“营业成本”科目中列报，导致2020年度主营业务毛利率整体有所降低。剔除运输费用因素影响后，公司2020年度主营业务毛利率为23.41%，较上年保持稳定。

发展篇

问：公司的战略规划是什么？

赵善麒：公司专注于功率半导体领域，坚持“以客户为中心，以创新驱动，以人才为根本”的发展理念，始终追求通过自主创新，设计、研发、生产国际一流IGBT、FRED、单管及其模块，打造具有影响力的民族品牌。公司已掌握核心的IGBT、FRED芯片设计、制造、测试及可靠性技术，开发出IGBT、FRED芯片及单管产品100余种，IGBT、FRED、整流二极管及晶闸管等模块产品400余种，电压范围从3A到1000A，电压范围从60V到2000V，产品类型齐全。

目前，公司与国外品牌在技术水平、规模化生产能力上还存在一定差距，公司未来将不断追赶国外领先技术与借鉴先进经验，同时借助资本市场力量，整合更多的上下游资源，引进更多的国内外功率半导体人才，以研发生产出更高效、高可靠

性的功率半导体器件，为国内整机应用客户提供更优质的产品。

公司将以芯片为核心，以模块为基础，以应用方案为牵引，努力建成国内一流的功率半导体芯片设计中心、国际一流的功率半导体模块封装生产基地，打造功率半导体产业链，使公司发展成为国内新型功率半导体器件和模块解决方案的领军企业，提高公司的市场规模，能够在国际上具有突出竞争力和影响力。

问：公司近期为实现战略目标已采取的措施有哪些？

赵善麒：为实现建成国内一流的功率半导体芯片设计中心、国际一流的功率半导体模块封装生产基地的发展目标，公司主要从产品开发、产能提升、市场开拓和人才引进四个方面采取了相关措施。

问：公司未来将采取哪些举措？

赵善麒：公司未来将采取加大产品与研发投入、提高产能与产品质量、积极开拓市场等举措，进一步提升产品竞争力和扩大市场份额。

问：公司的竞争优势体现在哪些方面？

赵善麒：公司的竞争优势主要包括：技术优势、产品链优势、多品种规模化供应优势、品牌及市场优势、人才优势这五方面。

问：请介绍公司主营业务的发展情况。

赵善麒：截至2020年末，公司资产负债率为45.30%，流动资产30636.87万元，流动负债17472.51万元。最近三年，公司业务发展情况良好，营业收入复合增长率达12.40%，净利润复合增长率达115.28%。总体来看，公司销售收入规模持续增长，盈利能力逐年增强。

行业篇

问：请介绍公司所处行业的分类情况。

范信龙：根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”，行业代码为“C39”；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），公司所属行业为“半导体分立器件制造”，行业代码为“C3972”；根据《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所属行业为“新一代信息技术产业”之“电子核心产业”之“新型电子元器件及设备制造”。

问：请介绍功率半导体行业的概况。

赵善麒：功率半导体器件是半导体器件的重要组成部分，是电力电子应用装备的基础和核心器件，主要用于电力电子设备的整流、稳压、开关、变频等，具有应用范围广、用量大等特点。功率半导体器件主要包括二极管、晶闸管、晶体管等产品，其中晶体管是市场份额最大的种类，晶体管又可以分为IGBT、MOSFET（金属氧化物场效应晶体管）和双极型晶体管等。功率半导体器件作为不可替代的基础性产品，广泛应用于工业控制、新能源发电和电能质量管理、汽车电子和汽车充电桩等领域，尤其是在大功率、大电流、高频高速、低噪声等应用领域起着无法替代的关键作用。

问：公司的市场地位如何？

赵善麒：公司曾荣获“新型电力半导体器件领军企业”“苏南国家自主创新示范区瞪羚企业”“PSIC2019中国新能源汽车用IGBT最具发展潜力企业”和“中国电气节能30年杰出贡献企业”等荣誉称号。

2011年，公司的“75—100A/1200—1700V”高压大电流平面型“NPT IGBT”系列产品，经江苏省经信委、常州市科技局等组织专家鉴定达到国际同类产品的先进水平，其中1200V产品部分主要性能指标超过国际同类产品的先进水平；“2—200A/200—1200V”超快速软恢复外延二极管（FRED）芯片性能指标达到国际同类产品的先进水平，“超快软恢复外延型二极管（FRED）系列产品”“一种新型的NPT IGBT结构”分别于2012年和2015年荣获中国半导体行业协会等授予的“中国半导体创新产品和技术奖”。2015年，公司“高压大电流高性能IGBT芯片及模块的产业化”项目获得江苏省人民政府“江苏省科学技术奖三等奖”，“一种新型的NPT IGBT芯片和模块的开发及产业化”项目获得中国电源学会科学技术奖一等奖。

公司能够满足不同终端客户对产品技术参数和性能多样性的需求，具有一定的市场占有率和较强的品牌影响力。公司凭借可靠的产品质量和优质的服务与众多知名企业客户保持了良好的商业合作关系，同时依托龙头客户产生的市场效应不断向行业内其他企业拓展。在工业控制领域，公司目前已经成为台达集团、汇川技术、合康

新能等多家变频器行业领军企业，佳士科技、奥太集团、上海沪工等多家知名电焊机行业企业的合作客户；在新能源领域，公司的主要客户群有盛弘股份、科士达、英可瑞、华为技术等众多优秀企业，市场份额不断扩大。其中在新能源汽车电控系统领域，公司车规级IGBT模块GV系列已实现对臻驱科技（上海）有限公司小批量供货，汇川技术、蜂巢电驱动力科技河北有限公司（长城汽车子公司）和麦格米特尚在对GV系列产品进行产品认证。

报告期内，我国IGBT行业自给率分别为14.12%、16.32%和18.36%，公司IGBT系列产品销量占我国IGBT行业产量的比例分别为10.12%、9.02%和9.85%。

问：行业内的主要企业有哪些？

赵善麒：行业内的主要企业包括斯达半导、士兰微、扬杰科技、华微电子、台基股份。

发行篇

问：请介绍公司控股股东和实际控制人情况。

丁子文：赵善麒直接持有公司23.7236%股份，为公司第一大股东；赵善麒提名4名非独立董事（占非独立董事半数以上）并当选，且赵善麒自公司设立以来一直担任公司董事长，赵善麒对公司董事会具有重大影响；赵善麒作为公司总经理，在公司经营管理方面具有重大影响，可以实际支配或者决定公司的重大经营决策、重要人事任命等事项。因此，公司控股股东、实际控制人为赵善麒。

问：请介绍持有公司5%以上股份的其他股东情况。

丁子文：截至招股说明书签署日，持有公司5%以上股份的其他股东分别是深圳常春藤、华泰战略、惠友创嘉、李福华、康路、九州创投和丁子文。

问：发行前后公司的股本是多少？

丁子文：本次公开发行前公司总股本为7387.00万股，本次公开发行新股不超过2462.3334万股，本次公开发行后的流通股数量占公司股份总数的比例不低于25%。

问：公司本次募集资金将用于哪些项目建设？

梅明君：公司本次发行募集资金将主要用于投资“新型电力半导体器件产业基地项目”“研发中心建设项目”“偿还银行贷款及补充流动资金项目”。

问：请介绍“新型电力半导体器件产业基地项目”的情况。

赵善麒：随着功率半导体下游应用领域需求的不断增长，IGBT面临巨大的需求增长空间。为了应对迅速扩大的市场需求与目前公司生产能力不足的问题，公司拟投资建设“新型电力半导体器件产业基地项目”。通过本项目建设，更好地实现标准化模块、定制化模块、新能源汽车模块和光伏模块四大系列产品的扩大生产，从而突破产能瓶颈，扩大主营业务产品的市场份额，进一步提高公司整体竞争优势，实现可持续健康发展。

问：请介绍“研发中心建设项目”的基本情况。

赵善麒：本项目通过购置先进研发设备，并引进高端人才，集中于“高电流密度、大功率IGBT芯片与模块”“续流二极管芯片”“RC IGBT（具有反向导通的绝缘栅双极型晶体管）芯片”“SiC（碳化硅）功率器件”“定制模块”等方向的新技术开发。

本项目的实施聚焦现有主营业务，依托公司现有研发基础，结合国际前沿技术，利用本项目提供的便利条件，对现有产品的技术和工艺进行改进和升级，满足未来市场的发展需要。本项目建设旨在通过提升公司现有工艺水平并研发新产品、开发新技术，使公司走在行业前列，并满足客户对公司产品性能及可靠性的需求。本项目的实施能够增强公司的技术实力，丰富产品种类，提高产品附加值，保持并扩大公司在优势产品上的影响力，进一步提升企业竞争力和盈利能力。

问：请介绍“偿还银行贷款及补充流动资金项目”的概况。

薛红霞：公司拟将本次募集资金中的8000.00万元用于偿还银行贷款及补充流动资金，满足公司快速增长的主营业务发展需要，进一步确保公司的财务安全，增强公司竞争力。